

Интенсивность фотолюминесценции сильно уменьшается при нагреве образца, и фотолюминесценция практически исчезает при нагреве образца до 200 °C.

Пreliminary исследования показали, что сигнал, связанный с жёлтой фотолюминесценцией, сильно изменяется по площади образцов AlGaN / GaN / SiC и AlGaN / GaN / Al₂O₃.

Видно, что образцы на подложках карбида кремния более неоднородные по уровню фотолюминесценции по сравнению с образцами гетероструктур на сапфировых подложках. Причина неоднородности фотолюминесценции в образцах пока не установлена, но неоднородность фотолюминесценции свидетельствует о неоднородности свойств гетероструктур по их площади.

Для получения более подробных данных выполнена разработка установки для автоматического построения «карт фотолюминесценции» по площади образца. При этом можно контролировать 48 участков фотолюминесценции для гетероструктур диаметром 2 дюйма или 108 участков фотолюминесценции для гетероструктур диаметром 3 дюйма.

На специально изготовленных тестовых образцах выполнены исследования по установлению связи между величиной фотолюминесценции и удельным сопротивлением омических контактов, которые используются в технологии GaN HEMT; показано, что внедрение операций входного контроля дефектности пластин перед запуском производства позволит существенно повысить процент выхода годных и снизить себестоимость конечных изделий.

Литература

1. T. Suski, P. Perlin, H. Teisseire, et al. // Appl. Phys. Lett. 67, 2188 (1995).
2. T. Kikkawa et al. // Phys. Status Solidi (a). 206, 1135 (2009).
3. A.P. Young, J. Bae, L.J. Brillson et al. // J. Vac. Sci. Technol. B 18, 2309 (2000).
4. G.H.Jessen http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038110102000758 – COR1mailto:jessen@ee.eng.ohio-state.edu, B.D. White, S.T. Bradley et al. // Solid-State Electronics, 46, № 9, 1427 (2002).

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ САПР СБИС

Моделирование элементов БИС с учетом радиационных эффектов

Петросяни К.О., д.т.н., профессор,
Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Московский институт электроники и математики), 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 34, Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, 124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Советская, д. 3, тел. +7 (495) 772 95 90, доб. 15208, kpetrosyants@hse.ru

Разработаны библиотеки TCAD- и SPICE-моделей интегральных биполярных и МОП-транзисторов, предназначенные для проектирования радиационно-стойких Би-КМОП БИС и учитывающие следующие виды радиационных воздействий: гамма-лучей, нейтронов, электронов, протонов, импульсного излучения и отдельных ядерных частиц (ОЯЧ).

TCAD-RAD-модели разработаны для БТ на основе Si и SiGe, а также для МОП-транзисторов на объемном кремнии и со структурой КНИ/КНС, в том числе для нанометровых приборов с high-k-диэлектриком затвора. С этой целью библиотека физических эффектов пакета Sentaurus Suporsys дополнена новыми радиационными моделями для подвижностей, времен жизни носителей заряда, концентраций дефектов и других электрофизических параметров. Часть моделей является универсальной для БТ и МОПТ, другая часть пригодна только для конкретных приборных структур. Для обеспечения необходимой

точности описания ВАХ и других характеристик п/п-прибора разработаны процедуры подгонки параметров моделей под результаты физических и электрических измерений тестовых структур.

SPICE-RAD-модели. Для Si БТ и SiGe ГБТ разработана универсальная модель, учитывающая влияние всех видов радиации. Эквивалентная схема и система уравнений неизменны; для каждого вида радиации различаются только параметры элементов эквивалентной схемы.

По сравнению с аналогами в модели учтены радиационные свидиги таких важных для БТ параметров, как $U_{\text{капас}}$, V_A , $U_{\text{кэпроб}}$.

Для МОПТ на объемном кремнии и со структурой КНИ/КНС разработаны две версии радиационной модели, построенные на стандартных платформах моделей BSIM и EKV. Радиационные эффекты учитываются с помощью двух подходов: введение в модель дополнительных функций для радиационно-зависимых параметров и подключения в эквивалентную схему дополнительных схемных элементов, учитывающих эффекты, вызванные радиацией.

Для определения параметров SPICE-RAD-моделей БТ и МОПТ разработаны методики, использующие программу-экстрактор параметров моделей IC-CAP и/или полуавтоматические процедуры, исходными данными для которых являются результаты измерений полученных и облученных транзисторов или результаты TCAD-RAD-моделирования. Модели включены в коммерческие пакеты программ SPECTRE, ELD0, HSPICE и др.

Точность TCAD- и SPICE-моделей составляет 10–15% при описании статических характеристик, 20–25% – динамических.

Приведены примеры использования моделей для расчета цифровых и аналоговых фрагментов радиационно-стойких Би-КМОПБИС, изготовленных по различным технологиям.

Ключевые слова: БТ- и МОП-транзисторы, TCAD- и SPICE-модели, радиационная стойкость, САПР.

Алгоритмы оптимизации ретроградного легирования кармана КНИ МОП-транзистора

Амирханов А.В., Волков С.И., Глушко А.А., Зинченко Л.А., Макарчук В.В., к.т.н., Шахнов В.А., Юлкин А.С., МВТУ

На базе системы приборно-технологического моделирования TCAD разработаны алгоритмы, с помощью которых была выполнена оптимизация режимов двухступенчатого ретроградного легирования кармана КНИ *n*-канального МОП-транзистора, что позволило почти в 2,5 раза повысить пороговое напряжение паразитного «донного» транзистора, увеличив стойкость СБИС, производимых с использованием оптимизированных режимов ретроградного легирования к накопленной дозе радиации.

Известно, что стойкость СБИС, производимых по SOI-технологии, к накопленной дозе ограничена величиной порогового напряжения так называемого паразитного «донного» транзистора, которое определяется величиной положительного заряда, захваченного отсекающим окислом. Отсюда следует, что одним из способов увеличения стойкости к накопленной дозе является повышение концентрации легирующей примеси в кармане КНИ *n*-канального МОП-транзистора вблизи отсекающего окисла, т.е. его ретроградное легирование.

В рассматриваемом технологическом маршруте формирование профиля легирования кармана КНИ *n*-канального МОП-транзистора проводится двухступенчатой ионной имплантацией. Для обеспечения ретроградности легирования кармана первая ступень выполняется с высокой энергией (порядка 70 кэВ) и большой дозой. Вторая ступень представляет собой имплантацию с малой энергией (порядка 15 кэВ). Именно она обеспечивает заданные свойства «основного» МОП-транзистора.

Задача оптимизации ставилась следующим образом: пелевая функция – пороговое напряжение паразитного «донного» транзистора; управляемые переменные – энергии и дозы первой и второй ступеней ионной имплантации; функции ограничений – сохранение электрических параметров «основного» транзистора в заданных пределах.